



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

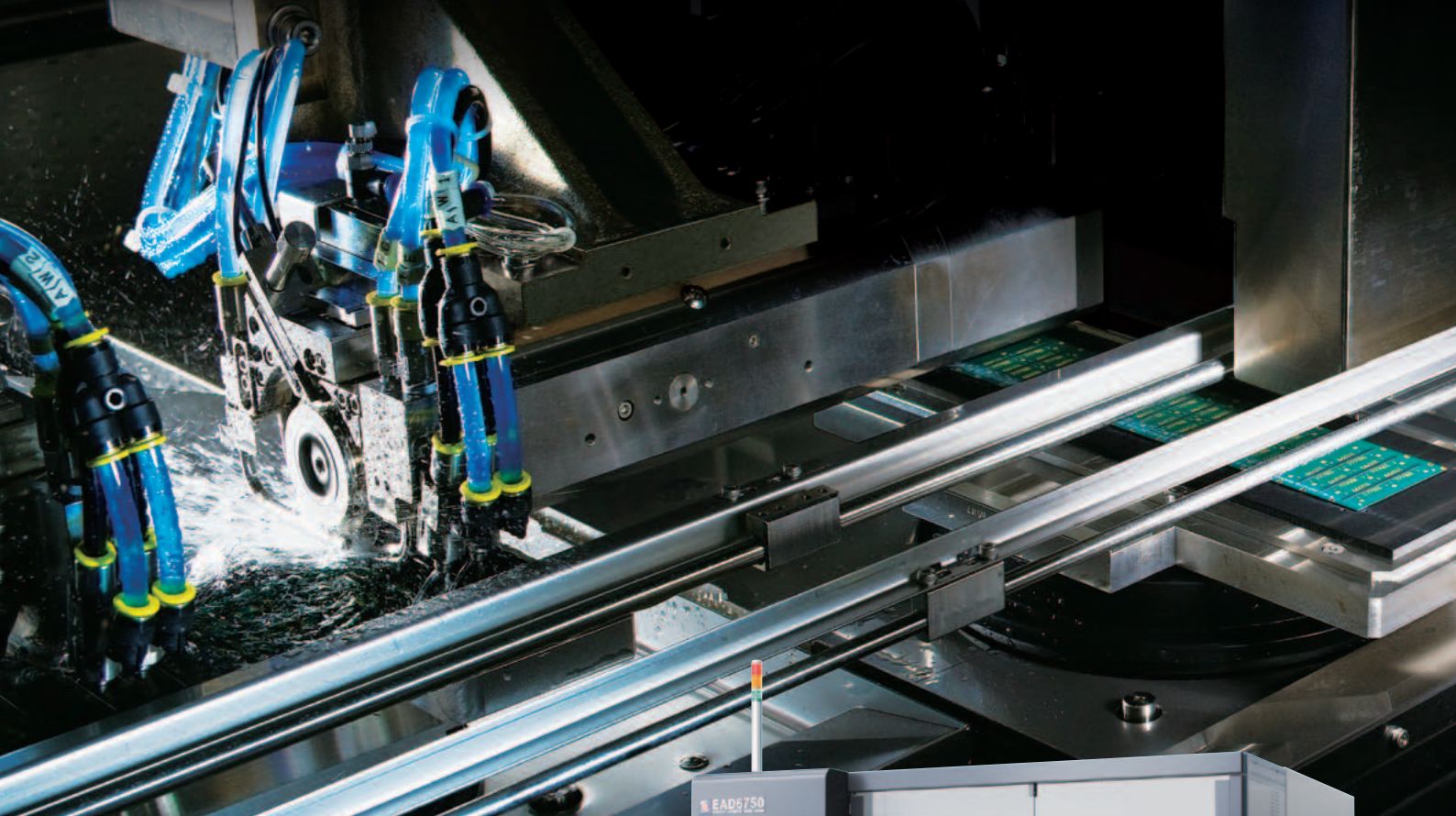


全自動機械切割引擎

EAD6750

Automatic Dicing Engine

高生產效率的半導體封裝切割用切割引擎



搭載雙工作台以提高產能的新世代切割引擎

EAD6750是以DFD6340半導體封裝分離成型專用機為基本，大幅提高產能而改良的切割引擎。搭載雙工作台（以下簡稱C/T）的EAD6750，一部C/T在加工作中時，因另一部C/T可同時進行輸送/定位校準/洗淨，可大幅縮短主軸的加工待機時間，以提高產能。此外還提高了各軸的返回速度，以縮短加工時間。

提高加工品質

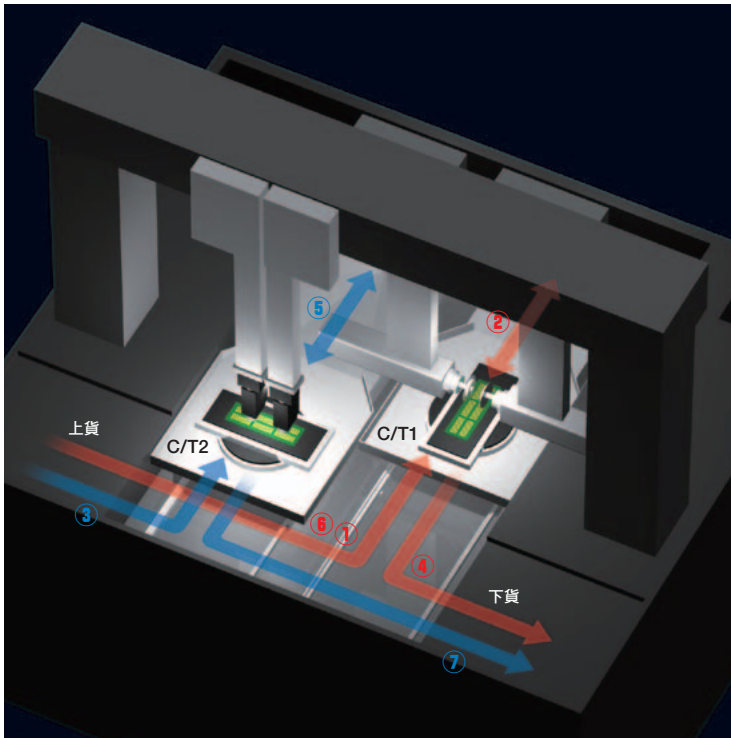
藉由改善真空機構，提升對工作物吸著力。藉此抑制工作物的翹曲，實現高品質的加工。

改善餘料處理方式

採用比蛇皮管耐用的不鏽鋼罩來處理餘料，降低因餘料造成蛇皮管破損的風險。還採用刷除機組，使回收餘料更容易。



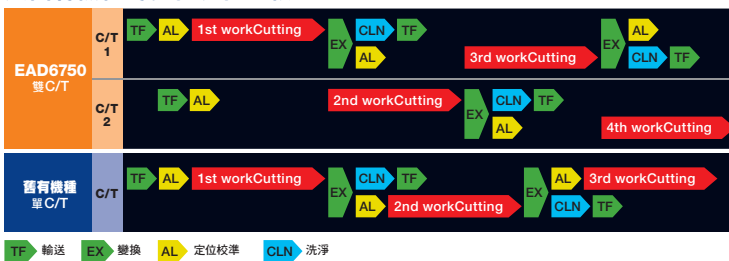
全自動機械切割引擎
EAD6750
Automatic Dicing Engine



■ 工作流程系統

- ① 將工作物輸送至C/T1後進行定位校準 →
- ② 在C/T1進行切割 →
- ③ C/T1開始定位校準後將下一個工作物送往C/T2進行定位校準 →
- ④ C/T1完成切割後輸送工作物 →
- ⑤ 在C/T2進行切割 →
- ⑥ C/T2進行切割中將下一個工作物送往C/T1進行定位校準 →
- ⑦ C/T2完成切割後輸送工作物

與舊有機種的製程流程比較



EAD6750 技術規格

		1.8 kW	2.2 kW
最大迴轉直徑	mm	340	
例	最大夾具尺寸	mm 300 × 160	
	最大工作物尺寸	mm 280 × 140	
X軸	可切割範圍	mm 300	
	進刀速度輸入範圍	mm/s 0.1 ~ 1,000	
Y1-Y2軸	可切割範圍	mm 300	
	單步步進量	mm 0.0002	
	定位精度	mm 0.003以內/660 (單一誤差)0.002以內/5	
Z軸	最大行程	mm 19 (使用φ2"切割刀片時)	20 (使用φ3"切割刀片時)
	移動量解析度	mm 0.00005	
	重複精度	mm 0.001	
θ軸	最大旋轉角度	deg 215	
主軸	額定扭矩	N·m 0.29	0.7
	旋轉數範圍	min ⁻¹ 6,000 ~ 60,000	3,000 ~ 30,000
其他規格	設備主機尺寸(W × D × H)	mm 1,510 × 1,554 × 1,800 (突起物除外)	
	設備重量	kg 約2,200	

■ 使用條件

- 請使用大氣壓露點在-15℃以下，殘餘油分為0.1 ppm，過濾度在0.01 μm/99.5%以上的清潔壓縮空氣。
 - 請將放置機械設備的房間室溫設定在20℃~25℃之間，並將波動範圍控制在±1℃以內。
 - 請將切削水的水溫控制為室溫+2℃(波動範圍在±1℃以內)，將冷卻水的水溫控制為與室溫相同(波動範圍在±1℃以內)。
 - 其他，請避免設備受到撞擊及外界的有感振動。另外，請不要將設備安裝在鼓風機、通風口、產生高溫的裝置及產生油霧的裝置附近。
 - 本設備會使用水。萬一發生漏水影響，請把本設備安裝在有防水性之地板及有排水處理之場所。
- ※為了改進設備，本公司可能在預先不通知用戶的情況下，就對本規格實施變更，因此請仔細確認規格後發出訂單。
※壓力全部使用壓力錶指示壓力值表示。
※關於本設備的應用技術等諮詢，請與本公司銷售部門聯絡。